



(株)PALTEK、物流コストを低減する紙梱包資材ソリューションを 提供開始

～ 紙梱包資材・システムのマーケットリーダーである Ranpak 社と販売代理店契約を締結 ～

株式会社PALTEK(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:矢吹尚秀、証券コード:7587、以下PALTEK)は、紙梱包資材・システムのマーケットリーダーであるRanpak BV.(本社:オランダ ヘーレン、CEO:Stephen Kovach、以下Ranpak社)と販売代理店契約を締結しました。PALTEKはRanpak社の紙梱包資材ソリューションを提供することで、物流コストの低減を望むお客様に対し、資材節約による梱包資材のコストの削減、梱包資材の保管スペースの削減、梱包作業高速化による労働コストの低減などトータルコストの削減を実現します。

現在、企業が事業活動を進める上で、環境への影響をできるだけ小さくしていくことが求められており、さまざまな分野で3R活動(Reduce/Reuse/Recycle)が実践されています。製品の配送で常に使用される梱包資材において、梱包用プラスチックの再利用率はわずか24%であるのに対して、梱包用紙資材の再利用率は73%にも上り、紙梱包資材の活用による環境負荷の低減が期待されます。また、通販市場の活況を背景に物流コストの上昇が懸念されており、お客様は物流コストの低減を図るソリューションを模索していると考えられます。

Ranpak社は、紙をもとにした梱包資材とシステムを提供しており、Ranpak社独自の技術により紙梱包資材は高い緩衝能力を発揮し、お客様の大切な荷物を守ります。Ranpak社所有のシステムを使用することで初期投資は不要であり、紙の持つ柔軟な対応力を生かし、緩衝、すき間埋め、ラッピングなど、さまざまな包装ニーズに対応できます。Ranpak社のシステムを利用することによって梱包作業の高速化を図り、労働コストを削減できます。また、梱包方法の見直しによる梱包資材コストの削減、資材の保管スペースの削減などを含め、トータルコスト削減を提案することができます。

Ranpak社は、輸送時に製品を保護するための紙を用いた梱包ソリューション製造におけるトップ企業であり、資材、システムおよび総合ソリューションコンセプトの継続的な開発を通じて、梱包業界における革新的リーダーとしての名声を高めてきました。Ranpak社はこれまで40年近くに渡り、紙緩衝システムや隙間埋めシステムで400件以上もの特許を取得しています。Ranpak社と販売代理店の協力により、エンドユーザーへの付加価値だけでなく、各国に根付いたサービスを創造し最適化しています。

PALTEKは、日本のエレクトロニクスメーカーに対して、FPGAやASSP、アナログ、メモリなどの半導体や受託設計サービスを提供し、エレクトロニクスメーカーの製品開発をサポートしてまいりました。Ranpak社の紙梱包資材ソリューションを取り扱うことで、既存顧客であるエレクトロニクスメーカーの物流サービス支援だけでなく、新規顧客の獲得、新規市場の開拓が可能となります。電気、精密、工業、医療、3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)・物流分野に向けて、Ranpak社の紙梱包資材システムソリューションを提供してまいります。

Ranpak社のManaging Director、Antonio Grassotti氏は次のように述べています。
「Ranpak BVはPALTEKと代理店契約を実現することができ、嬉しく思います。我々は過去数十年間、インパックス・パッケージング・ソリューションで市場のリーダー的立場を築いてきており、顧客は、保護の質やパッケージング作業に及ぼす当社システムの効率性、紙主体ソリューションの持続可能性の面からRanpakを

選んでいます。日本の電気電子業界での我々の重要性は年々増しており、品質のみならず市場から求められる梱包作業の効率化において Ranpak は高いプレゼンスをPALTEKと共に提供できるものと確信しています。」

株式会社PALTEKの代表取締役社長 矢吹尚秀は次のように述べています。
「環境への配慮、労働人口の減少は日本の産業界にとって共通の課題となっています。Ranpak社製品のシンプル、エコ、高い柔軟性はさまざまな課題への解決策を示し、日本の産業界へ革新をもたらすことができると考えています。今後、既存の電気電子業界のみならず、物流業界全般へも積極的に展開し、ソリューションビジネスを加速してまいります。“多様な存在との共生”という当社の理念とも合致したRanpak社製品を取り扱うことができ、たいへん嬉しく思います。」

Ranpak社製品に関する詳細は、ウェブサイト <http://www.paltek.co.jp/products/ranpak/> をご覧下さい。

Ranpak社の製品

PadPak SR

重くて壊れやすいもの
大きな製品の梱包に



PadPak LC

軽いもの、壊れ易い包装
済みの製品の保護に



FillPak TT/TTC

高速梱包が必要な
現場に



Geami WrapPak®

固定テープ不要
美しい見た目による付加価値
エアキャップの代わりに



Ranpak社について:

Ranpak社は世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上に渡る経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。

Ranpak BV は、欧州およびアジアに 100 以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリスなど)の成熟市場、東ヨーロッパ(ポーランド、スロバキア、トルコ)の発展途上市場、およびアジア太平洋(オーストラリア、日本、シンガポールなど)など、世界中に拠点があります。

Ranpak社に関する詳細は、ウェブサイト <https://www.ranpak.com> をご覧下さい。

株式会社PALTEKについて:

PALTEKは、1982年の創業以来、日本の電気電子メーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。

PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、ウェブサイト <http://www.paltek.co.jp> をご覧下さい。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1: ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : 広報担当 柴崎 由記

メールアドレス : pr@paltek.co.jp

住所 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話 : 045-477-2016 FAX : 045-477-2012

2: 製品に関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : デザインサービス事業部

メールアドレス : info_pal@paltek.co.jp

住所 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話 : 045-477-2009 FAX : 045-477-2010